证券代码：603501　　证券简称：豪威集团　　公告编号：2026-078
转债代码：113616　　转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司 2026年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据，可能与公司2026年第三季度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司正式披露的2026年第三季度报告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、2026年第三季度主要经营数据

经财务部门初步估算，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第三季度实现营业收入75.78亿元至81.30亿元，较上年同期变动范围为-3.18%至3.87%，较上季度变动范围为-0.43%到6.83%；公司毛利率约为29.35%至30.65%。

二、2026年第三季度经营情况

2026年第三季度，凭借在视觉感知领域的技术积淀与持续的产品结构优化，公司展现出较强韧性；伴随智能驾驶、专业影像、机器视觉与机器人等产品线营收占比的持续提升，公司营业收入有望实现有序增长。与此同时，半导体设计业务在智能驾驶及AI相关应用场景的布局不断深化，高端产品份额扩大，带动毛利率环比稳步提升。

公司将持续优化业务结构，积极开拓新兴下游应用场景，紧抓人工智能带动的视觉感知升级机遇，持续深化技术创新与先进技术成果转化，推动端侧AI、机器视觉与机器人、智能驾驶等新兴场景落地，持续丰富高端应用领域的产品布局。同时，公司将进一步强化供应链管理和成本管控，着力改善盈利能力，促进业务高质量发展。

三、风险提示

本公告所涉及的主要经营数据为初步核算数据，可能与公司2026年第三季度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司正式披露的2026年第三季度报告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码：603501　　公司简称：豪威集团
转债代码：113616　　转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪威集团	603501	韦尔股份
H股	香港联合交易所	豪威集团	00501	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任冰	周舒扬
电话	021-50805043	021-50805043
办公地址	上海市浦东新区上科路88号	上海市浦东新区上科路88号
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com	will_stock@corp.ovt.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	50,140,959,427.59	43,600,508,995.65	15.00
归属于上市公司股东的净资产	32,707,865,094.94	28,172,055,029.35	16.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	14,024,560,916.08	13,955,815,139.72	0.49
利润总额	1,518,961,051.16	2,192,049,914.71	-30.71
归属于上市公司股东的净利润	1,219,762,603.08	2,027,879,812.52	-39.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,242,455,735.23	1,951,351,981.31	-36.33
经营活动产生的现金流量净额	407,900,244.31	1,888,150,247.66	-78.40
加权平均净资产收益率（%）	3.73	8.01	减少4.28个百分点
基本每股收益（元／股）	0.97	1.69	-42.60
稀释每股收益（元／股）	0.97	1.68	-42.26

2.3 报告期内公司主要业务简介

2.3.1 公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

2.3.2 行业发展情况

（1）全球半导体行业发展情况

当前，大语言模型、生成式人工智能以及端侧AI应用的快速迭代，正在加速技术深度融合与应用场景创新，全面推动智能汽车、人工智能物联网（AIoT）、空间计算及工业机器人等终端市场提速发展，伴随算力基础设施建设与AI终端需求的强劲释放，全球半导体产业呈现出显著的结构性高景气运行态势。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）2026年8月发布的统计及测算数据，2026年上半年全球半导体市场实际规模达到7,020亿美元，同比增长102%；基于上半年行业实际经营表现测算，预测2026年全球半导体市场规模将达到1.655万亿美元，同比增长108%；预测2027年全球半导体市场规模将达到2.1万亿美元，同比增长29%。

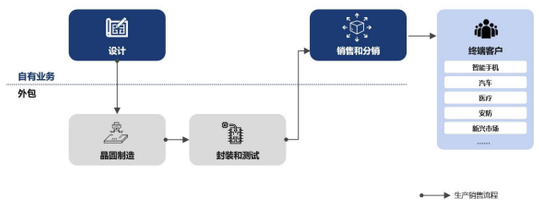
（2）中国半导体行业发展情况

中国作为全球最大的消费电子及工业产品制造中心，终端消费市场的庞大需求为本土半导体企业提供了广阔的发展空间。在中国市场，半导体产业正处于“供应链自主可控与高端技术集群升级”的双轮驱动阶段。根据Frost & Sullivan的数据，预计自2025年起，中国半导体规模以11.8%的年复合增长率稳步扩大，并于2029年达到3,740亿美元。据中国海关总署2026年7月发布的半年度进出口数据，2026年6月当月集成电路出口额达382.1亿美元，占当月出口总值的9.3%，为单月第一大类出口商品；2026年1-6月中国集成电路累计出口额1,772.8亿美元，同比增长96.1%，出口量1,794.4亿颗；累计进口额约2.06万亿元人民币，进口量3,047亿颗。

2.3.3 公司业务模式

（1）公司半导体设计销售业务采用Fabless的业务模式

公司半导体设计销售业务属于典型的Fabless模式，公司仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试。



公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，与公司有着长期稳定的合作关系，产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广，根据行业、市场及产品需求情况，公司相应选择直销和代销的方式进行销售。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM厂商、OEM厂商及终端客户，直销模式可以保障公司服务效率，根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外，公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式，公司可有效降低新客户开发的成本，在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时，也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

（2）公司设计业务产品类型

目前公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。具体产品如下图所示：

2.3.4 公司代理销售业务产品类型

公司为典型的技术型半导体授权代理销售商，与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的FAE队伍，顺应国内半导体行业的产业地域布局，公司代理销售体系境内外多地设立了子公司，构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

代理销售业务产品覆盖电子元件、结构器件、机电系统、集成电路、射频器件等，覆盖了移动通信、家用电器、安防、智能穿戴、工业设备、电力设备、电机控制、仪器仪表、汽车部件、消防、数据中心等诸多领域。

产品名称	细分产品	主要代理原厂
电子元件	电阻、电容、电感、晶振等	松下、乾坤、国巨、三星、华新科、华德、TXC等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB、神凯、驻极体等	莫仕、松下、南亚、共达等
机电系统	同服、电机、风扇、PLC等	松下、NIDEC、台达等
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash、传感器、二三极管等	光宝、江波龙、XMC、昆腾微、韵略、荣湃、力生美、芯昇、前海维晟、海栎创、爱芯、九天睿芯、国民技术、BOSCH、傅里叶、易冲等
射频器件	滤波器等	松下、ACX、佳利、华莹、芯朴、华新科等

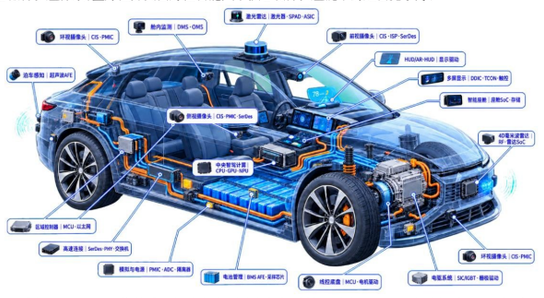
公司根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素，对所代理的产品线进行动态管理。半导体代理销售业务是公司了解市场需求的重要信息来源，在维持现有的半导体代理销售业务销售规模的背景下，公司将与下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系，及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求，有针对性地进行技术研发和储备，使企业的新技术能顺应市场变化，减少下游行业变化带来的负面影响，助力公司半导体设计销售业务迅速发展。

2.3.5 公司产品主要应用

作为全球领先的CMOS图像传感器供应商，公司依托在图像传感器解决方案领域的深厚技术积淀与市场优势，持续推动模拟解决方案和显示解决方案协调发展，围绕人工智能时代下游终端在感知、传输、处理与显示等方面的核心需求，构建从环境感知到信号传输、从数据处理到显示交互的全链路芯片解决方案能力。公司产品目前已实现在汽车、智能手机、专业影像、机器视觉与机器人、端侧AI终端、医疗、安防及光通信与AI算力基础设施等领域。

（1）汽车市场

伴随汽车行业智能化转型升级，公司在汽车领域的业务布局从深度及广度实现了积极拓展。依托在车载视觉感知领域的成熟配套落地经验，稳步向外延伸，以智能驾驶为核心进一步全面切入智能座舱域信号传输、车载电源管理、车载显示驱动等多维赛道，逐步搭建起串联环境感知、数据传输、人机交互的全链路业务布局，构筑起覆盖“感知采集—信号传输—终端显示”全链条的系统化车规级核心器件供应体系，全方位夯实自身在智能汽车核心硬件供应链中的配套竞争力。



感知层面，公司图像传感器解决方案覆盖高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶（AD）、驾驶员与乘员监测（DMS/OMS）、电子后视镜、仪表盘摄像头及后视与全景影像等应用场景。为满足复杂光照与全天候工况下的稳定成像要求，公司积累了有效抑制LED闪烁的分离像素技术、同时实现高动态范围与LED闪烁抑制的HALE组合算法，以及基于TheiaCel?技术平台的DCG+LOFIC解决方案；面向舱内低照度场景，公司Nyxel?近红外技术可显著提升940纳米波长下的量子效率，增强DMS与OMS在暗态环境下的识别性能。

显示层面，公司LCOS产品采用反射式投影技术，相较目前主要应用的DLP方案具备更高的透光率与耐热性，目前已在汽车AR-HUD方案中实现量产交付。同时，伴随车载显示应用场景由传统中控、仪表延伸至副驾娱乐、抬头显示、后排大屏及流媒体后视镜等领域，公司持续投入车载显示驱动芯片研发，并已获得客户验证导入。

模拟层面，汽车电子电气架构（EEA）加速由分布式向域集中式演进，越来越多的电子控制单元（ECU）集成至域控制器中，对芯片的性能、功能安全、信息安全与稳定性提出更高要求。公司依托在车载领域长期积累的品牌优势、客户资源与车规验证体系，横向拓宽车载模拟产品矩阵，推出包括加串器/解串器（SerDes）、电源管理芯片（PMIC）、微控制器（MCU）及系统基础芯片（SBC）等在内的车载解决方案；SerDes面向环视、周视、后视及舱内监测等场景提供高速视频链路支撑；PMIC负责域控制器与摄像头模组内部功率流的调节、转换、分配与保护；MCU面向智能座舱、车身域控、门控制器、热管理及电池管理等场景；SBC则以高集成度方案覆盖座椅控制、门窗、热管理及车灯等车身控制应用。相关产品需满足AEC-Q100车规认证、宽温域稳定工作及ASIL-B/D功能安全等级要求。随着智能驾驶等级提升与座舱交互功能升级，单车摄像头搭载数量、显示屏数量及模拟器件用量同步增长，公司围绕汽车电子的多产品线协同优势将进一步凸显。

（2）新兴应用市场

①专业影像终端

当前运动相机、全景相机、航拍无人机等专业影像终端持续升级，针对行业对远距离拍摄解析力不足、逆光强光下画面明暗失衡、高速抓拍拖影模糊、高画质模式下功耗偏高、长时间录制续航承压等一系列核心规格痛点，公司在大底高像素、超高动态范围和低功耗方面具备核心技术优势。基于硬件底层能力，客户可以在远距离航拍时获得超清解析，在高速抓拍时做到无损，同时在大动态范围场景下也能保持出色成像。即便遇到逆光、强光、快速运动或高空远距离等复杂条件，输出的画面依然干净稳定，层次完整。同时，依托优异的功耗控制能力，在优化影像性能的同时也兼顾了长时间高清录制需求。目前公司已是行业头部品牌核心图像传感器供应商，充分支撑终端设备落地全焦段专业视频录制、高精度图像采集等高阶影像能力。

②机器视觉与机器人

机器视觉依托光学器件模拟人眼视觉感知，为产线自动化、人形机器人赋予辨识能力，助力机器人实现“信息采集—分析决策—精密执行”完整技术闭环，下游覆盖机器视觉、具身智能数据采集、机器人视觉三大高成长领域。机器视觉承接制造现场工件检测、精准定位与动态交互需求，结合自研低光高灵敏度成像方案，保障复杂环境下稳定、高清的视觉采集能力。算力层面，公司创新采用CIS集成NPU的芯片级融合架构，实现图像感知与AI算力一体化集成，支持端侧数据采集、运算本地化处理，显著降低设备延迟、功耗与模组体积。此外，公司CameraCubeChip?晶圆级摄像头模组技术，可充分满足端侧终端微型化设计需求。在显示领域，公司自研LCOS单芯片显示解决方案具备高分辨率、小体积、低功耗、高性价比等优势，适配端侧设备高清显示交互的升级需求。公司凭借感知、算力集成、微型化封装、高清显示的全链条技术优势，深度卡位端侧AI优质赛道，持续助力下游终端产品智能化升级，目前已在国内外头部客户实现量产导入。

（3）消费电子市场

在传统消费电子领域，公司深耕智能手机、笔记本电脑、平板电脑等主流泛消费终端市场，依托图像传感器、显示驱动芯片、模拟芯片协同配套的全栈技术能力，为下游客户提供一体化硬件解决方案，持续赋能消费电子终端的影像性能升级、人机交互体验优化与整机功耗精细化管控，在成熟消费电子市场形成稳定的产品应用与客户配套基础。

①智能手机

图像传感器解决方案使智能手机制造商能够向消费者提供专业级影像效果。消费者通过智能手机的相机功能，捕捉和分享生活中的时刻。随着智能手机取代独立相机成为消费者的首选应用，其对成像技术的要求也大大提升。

公司先进的图像捕捉技术使用户能够捕捉高质量的静态和视频图像，同时保持高标准的性能。公司已经掌握从像素架构到图像捕捉技术的全套核心技术，以及用于全球最小的晶圆级摄像头模组的CameraCubeChip?技术。公司量产销售广泛用于其旗舰机型的高分辨率图像传感器，同时努力加强公司在像素微型化和图像分辨率方面的竞争优势。

同时，公司继续致力于提供行业领先的显示以及模拟解决方案，公司在相关领域持续进行研发投入从而推动公司技术不断发展。公司的TDDI技术广泛地被智能手机客户采用。公司新研发的OLED DDIC产品已得到中国领先的面板供应商测试和批准。近年来，智能手机市场对电池容量和充电速度的需求也在以惊人的速度增长，公司的模拟产品帮助客户较好的解决了功率密度和电源管理需求。

②笔记本电脑与物联网应用

公司面向笔记本电脑与智能物联网等应用场景，提供业界领先的图像系统解决方案，应用场景已超越传统视频通话与视频会议。以眼球追踪、面部识别、虹膜识别为代表的新兴功能，正持续提升终端设备的交互体验与安全认证能力，也带动了红外全局快门传感器、RGBIR融合成像等新一代技术的快速普及与需求增长。另一方面，消费电子终端普遍在小型化、长续航与高能效要求，公司模拟解决方案可为该类终端提供电源管理、电池充放电管理及接口保护等配套器件，与影像、显示产品形成协同供应。

（4）医疗市场

受人口老龄化、微创诊疗普及及远程医疗快速发展带动，图像传感器解决方案在医疗市场的需求也在快速增长。行业技术持续迭代，CMOS图像传感器凭借小型化、高画质、低成本优势成为主流，推动医疗设备向高清化、轻量化、低功耗升级。公司凭借全球最小的晶圆级摄像头模组的CameraCubeChip?技术进一步推进了内窥镜应用市场向一次性可抛弃式方案的变革，一次性内窥镜与诊疗导管凭借更低的交叉感染风险、更高的临床安全性，加速替代传统复用设备，持续拓宽医用CIS应用场景。凭借深厚的成像技术积累与医疗级品质管控体系，公司持续优化医疗成像产品，满足医疗设备高清晰、高稳定、高安全的核心要求，充分受益于微创医疗普及、一次性医用耗材替代及医疗影像国产化趋势，稳步提升在高端医疗成像器件领域的竞争实力。

（5）安防市场

安防监控正处于智能化、高清化迭代升级的关键阶段，公司在该市场的产品配套覆盖成像与供电保护两个环节。安防摄像头广泛应用于公共交通、办公楼宇等大型场景，同时已成为智能家居的重要组成部分。公司Nyxel?近红外技术建立在PureCel?Plus像素架构之上，使安防摄像头能够在低光环境下看得更清楚、更远，同时具备更低功耗；公司高分辨率、低功耗、高灵敏度的图像传感器已获得市场广泛认可。此外，公司在家居安防应用的节能电源管理解决方案及接口保护产品方面持续处于行业前沿。

（6）光通信与AI算力基础设施

面向AI算力基础设施对高速率、低功耗、高可靠光传输的需求，公司围绕高速互联芯片、光模块高速模拟电芯片及光通信核心器件加大研发、丰富产品矩阵。在高速互联芯片领域，推进高速SerDes/接口芯片与信号调理芯片研发；在光模块模拟电芯片领域，重点布局跨阻放大器（TIA）、激光驱动器（LD Driver）等收发端核心器件。在光通信器件领域，持续迭代LCOS空间光调制器及配套驱动控制方案，巩固其在波长选择开关（WSS）中的地位，拓展骨干网、城域网及数据中心OCS交换机市场；同时，面向AI服务器机柜内/板间短距、并行化、低功耗光互联趋势，Micro-LED有望成为未来互联方案之一，公司前瞻预研与通信波段Micro-LED发射阵列匹配的硅基PD光电探测芯片，重点提升响应度、带宽、暗电流及阵列一致性，并加强与接收端低功耗模拟前端（TIA/判别电路）的协同设计。

2.4 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				219,449（其中A股股东219,435户，H股股东14户）			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
虞仁荣	境内自然人	24.06	303,472,250	0	质押	171,790,000	
香港中央结算有限公司	其他	7.93	100,028,511	0	无	0	
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.88	74,132,662	0	质押	15,856,000	
宁波东方理工大学教育基金会	其他	5.64	71,200,100	0	无	0	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4.02	50,739,939	20,740,200	无	0	
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	其他	1.77	22,375,676	0	无	0	
豪威集成电路（集团）股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.85	10,715,163	0	无	0	
马列秋	境内自然人	0.57	7,207,900	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	6,298,793	0	无	0	
宁波市虞仁荣教育基金会	其他	0.48	6,090,410	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2026年上半年，公司实现营业收入140.25亿元，较2025年上半年同期增长0.49%；公司归属于母公司股东的净利润为12.20亿元，较2025年上半年降低39.85%。

具体详见公司2026年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

证券代码：603501　　证券简称：豪威集团　　公告编号：2026-077
转债代码：113616　　转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的《企业会计准则解释第20号》以及《企业会计准则第25号——保险合同》的要求进行的变更，不会对公司拟益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更依据

1、2026年6月17日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，该解释自公布之日起施行。

2、财政部于2020年12月24日修订发布了《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2023年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日起执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第20号》《企业会计准则第25号——保险合同》的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

（二）变更时间

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

（三）变更内容

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》《企业会计准则第25号——保险合同》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部企业会计准则解释相关新规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-034

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

公司完成H股发行上市后，公司总股本由2,007,591,697股变更为2,234,645,597股，注册资本由人民币2,007,591,697元变更为人民币2,234,645,597元。公司结合前述变更注册资本事项及公司实际情况，修订《公司章程》。公司将在审议程序完成后及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》的变更、备案等手续。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

修订《公司章程》中涉及管理层设置调整的相关条款尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-028）。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2026年半年度报告及其摘要，其中A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股半年度报告包括中期业绩公告和中期报告。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第十八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2026年半年度报告》和《晶合集成2026年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《晶合集成2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

（四）审议通过《关于＜公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

董事会同意公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023激励计划》”）等相关规定，《2023激励计划》预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为141,613股。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《2023激励计划》的相关规定为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

（六）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

同意公司作废合计893,765股不得归属的限制性股票。公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经第二届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。

（七）审议通过《关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的议案》

同意提名杨国庆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意相应调整公司第二届董事会专门委员会组成。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

董事及独立董事任职资格已经第二届董事会第五次提名委员会审议通过，补选董事及独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会组成的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任方华女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

高级管理人员任职资格已经第二届董事会第五次提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。

（九）审议通过《关于申请新项目自动化设备及生产系统预算的议案》

同意新项目自动化设备及生产系统预算申请。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于申请厂房租赁项目预算的议案》

同意厂房租赁项目新增预算申请。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过《关于公司拟参与投资晶汇新芯基金的议案》

同意公司作为有限合伙人，出资5,000万元参与投资苏州工业园区晶汇新芯创业投资合伙企业（有限合伙）。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-028

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于合肥晶合集成电路股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1134号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于2026年7月10日公开发行216,167,000股（行使超额配售选择权之前）H股并在香港联交所主板挂牌上市；公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2026年8月6日部分行使超额配售权，涉及合计10,886,900股H股，该等超额配售股份于2026年8月11日在香港联交所主板上市及买卖。前述超额配售权部分行使后，本次公开发行共计227,053,900股H股股份。

本次发行完成后，公司总股本由2,007,591,697股变更为2,234,645,597股，注册资本由人民币2,007,591,697元变更为人民币2,234,645,597元。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司完成H股发行上市事项，公司将《合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时结合公司变更注册资本及公司实际情况，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订。具体修订对照表如下：

修订前	修订后
第三条 公司于2022年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股501,533,789股，于2023年5月5日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。 公司于2026年5月19日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市外资股【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。……	第三条